

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2012-018号

吉林华微电子股份有限公司

(吉林省吉林市高新区深圳街99号)

2011年公司公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)上市推荐人

(北京市西城区金融大街8号)
二〇一二年四月

吉林华微电子股份有限公司(下称“华微电子”、“公司”、“本公司”或“发行人”)董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,因公司经营和市场变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行承担。

经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)评定,本期公司债券信用等级为AA,截至2011年12月31日,华微电子净资产167,432.22万元,合并报表中所有者权益合计数为1.63亿元,最近3个会计年度实现的平均可分配利润7,009.01万元。2009年-2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值为1.84亿元,本期债券一年利息的1.5倍;且2009年度实现的可供分配利润为1,603.70万元,2010年度实现的可供分配利润为8,249.09万元,2011年度实现的可供分配利润为10,174.25万元,均不低于本期债券的一年利息。

第一节 绪言

重要提示

一、发行人概况
1.中文名称:吉林华微电子股份有限公司
英文名称:Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd
2.法定代表人:夏继文
3.注册地址:吉林省高新区深圳街99号
4.邮政编码:132013
5.成立日期:1999年10月21日
6.注册资本:67,808万元
7.营业执照注册号:22020000001250
8.股票上市地:上海证券交易所
9.股票简称:华微电子
10.股票代码:600360
11.董事会秘书:夏继文(代)
12.联系电话:0432-64678411
13.传真:0432-64665812
14.互联网网址: http://www.hwdz.com.cn

第二节 发行人简介

一、发行人的经营范围:半导体分立器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用软件的研制、设计、制造与销售;经营企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;氢气、氧气、工业级空气、氮气生产(安全生产许可证有效期至2013年1月31日)。
公司的半导体业务是在吉林华微电子集团有限公司的半导体资产的基础上发展而来,拥有四十余年的功率半导体器件生产运营历史,目前拥有功率半导体芯片从设计、研发、制造、封装到销售的完整产业链,公司作为国内功率半导体行业的大型企业,拥有3英寸3片装,188片4寸片,67片5寸片,48片6寸片的芯片加工设计能力。公司在集中力量发展芯片开发和生产的同时,加强扩充封装能力,目前已经形成7.5亿只年的测试封装能力。
在公司产品结构中,半导体器件的制造与销售占主营业务的85%以上,是公司收入和利润的主要来源。公司半导体器件产品主要包括CMOS芯片、FRED芯片、双极型功率晶体管、可控硅、二极管、彩电管、肖特基二极管、VDMOS/IGBT等。
公司产品广泛应用于彩电电视机、白色家电、绿色照明、计算机、汽车电子、移动通信、机电一体化等多个领域,公司产品质量达到国际IEC标准,性能达到国际先进水平,获SCS公司 国际标准技术服务有限公司OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,并通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的三大体系认证。
按照地区划分,目前公司产品以内销为主,主要集中在华东、华南地区,在积极拓展国内市场的同时,公司加大了对国外市场的拓展力度,出口收入保持较快增长的趋势。
二、发行人设立、上市及股本变化情况
(一)发行人的设立情况
公司前身吉林华星科技股份有限公司,系经吉林省经济体制改革委员会1999年10月20日的吉改股批[1999]200号《关于同意设立吉林华星科技股份有限公司的批复》批准,由吉林华星电子集团有限公司作为发起人,联合合康长虹(集团)有限公司、厦门永红电子有限公司、广州乐华电子有限公司、吉林永鼎集团有限公司共同发起设立的股份有限公司,公司于1999年10月21日,注册资本67,800万元,其中,吉林华星电子集团有限公司以经评估后的净资产总额9,900万元折合6,600万股国有法人股;国管长虹集团、厦门永红电子有限公司、广州乐华电子有限公司、吉林永鼎集团有限公司分别投入现金75万元,按1:1的价格分别折合50万股。公司设立时的股本结构如下:

发起人名称	股份类型	股份数量(股)	持股比例(%)	2009年度
吉林华星电子集团有限公司	国有法人股	9,900	66.0000	97.06
国管长虹集团	社会公众股	75	500,000	0.735
厦门永红电子有限公司	社会公众股	75	500,000	0.735
广州乐华电子有限公司	社会公众股	75	500,000	0.735
吉林永鼎集团有限公司	社会公众股	75	500,000	0.735
合计		10,200	68,000,000	100.00

2003年5月15日,经吉林省经济体制改革委员会吉改函[2003]6号《关于同意吉林华星科技股份有限公司更名为吉林华微电子股份有限公司的函》批准,公司名称由吉林华星科技股份有限公司变更为吉林华微电子股份有限公司。
二、发行人设立后上市及股本变化情况
1.2001年首次公开发行股票并上市
2001年4月20日,经中国证监会证监发行字[2001]18号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股,发行价格为42元/股,发行后,公司总股本增至11,800万股,2001年3月16日,经上海证券交易所上市。2001年3月30日,经上海证券交易所公告,公司于2001年3月30日上市交易的通知同意,公司向社会各界发行的人民币普通股股票在吉林华微电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知同意,公司向社会各界发行的人民币普通股股票在吉林华微电子股份有限公司上市交易。
首次公开发行股票后,公司的股本结构如下表所示:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股	68,000,000	57.63
其中:		
国有法人股	66,000,000	55.93
社会公众股	2,000,000	1.70
二、已上市流通股	50,000,000	42.37
合计	118,000,000	100.00

2.国有法人股部分转让
2003年,根据吉林省丰满区人民法院[2003]执字第1号《民事裁定书》和[2003]执字第1号《执行和解协议》,上海瀚海科技实业有限公司(2008年7月21日更名为上海鹏盛科技股份有限公司)受让了吉林华微电子股份有限公司持有的公司33,726,531股国有法人股,约占总股本的28.58%,成为公司第一大股东。本次股份转让后,公司股本结构如下:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股	68,000,000	57.63
其中:		
国有法人股	64,546,938	27.35
社会公众股	71,453,062	30.28
二、已上市流通股	100,000,000	42.37
合计	236,000,000	100.00

3.2005年非公开发行股票转增股本
2005年9月26日,公司2005年第一次临时股东大会审议通过2005年中期资本公积转增股本方案,即以总股本11,800万股为基数用资本公积金向全体股东每10股转增1股,实施本次转增方案后,公司总股本增至23,600万股,股本结构如下所示:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股	136,000,000	57.63
其中:		
国有法人股	64,546,938	27.35
社会公众股	71,453,062	30.28
二、已上市流通股	100,000,000	42.37
合计	236,000,000	100.00

4.国有法人股部分转让
2006年4月19日,根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1439号文《关于吉林华微电子股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,吉林省人民政府国有资产监督管理委员会、吉林华星电子集团有限公司与北京光大汇金投资有限公司签订《吉林华星电子有限公司国有法人股股权转让协议》,约定吉林华星电子集团有限公司将其持有的本公司2,400万股国有法人股转让给北京光大汇金投资有限公司。本次股份转让后,公司股本结构如下表所示:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股	136,000,000	57.63
其中:		
国有法人股	40,546,938	17.18
社会公众股	95,453,062	40.45
二、已上市流通股	100,000,000	42.37
合计	236,000,000	100.00

5.股权分置改革
2006年6月9日,根据吉林省人民政府国有资产监督管理委员会的批复《国资产权[2006]100号》并经相关股东大会审议通过,公司股权分置改革方案实施完毕,即以流通股股份10,000万股为基数,非流通股股份按照10:2.5的比例向流通股送股,送股后无限售流通股为12,500万股。股权分置改革后公司股本总额没有发生变化,其股本结构如下表所示:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件流通股	111,000,000	47.03
其中:		
国有法人股	21,234,130	9.00
其他境内法人股	89,765,870	38.03
二、无限售条件流通股	125,000,000	52.97
合计	236,000,000	100.00

6.2007年度非公开发行股票
2007年12月18日,根据中国证监会证监发行字[2007]444号文《关于核准吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,公司6名特定投资者非公开发行2,480万股,发行后,公司股份总数增至26,080万股,公司股本结构如下:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件流通股	109,584,339	42.02
其中:		
国有法人持有股份	10,000,000	3.84
其他有限售条件流通股	99,584,339	38.18
二、无限售条件流通股	151,215,661	57.98
合计	260,800,000	100.00

7.2008年非公开发行股票
2008年4月25日,公司2007年年度股东大会审议通过资本公积转增股本方案,即以总股本26,080万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增1股,转增后,公司总股本增至52,160万股,公司股本结构如下:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件流通股	219,168,678	42.02
其中:		
国有法人持有股份	20,000,000	3.84
其他有限售条件流通股	199,168,678	38.18
二、无限售条件流通股	302,431,322	57.98
合计	521,600,000	100.00

8.国有股权无偿划转
2009年1月15日,根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1439号文《关于吉林华微电子股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,公司国有股东吉林华星电子集团有限公司将持有的公司1,000万股国有股权(无限售流通股)无偿划转至吉林省中小企业信用担保有限公司。

9.2011年度股及资本公积转增股本
2011年5月6日,公司2010年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案,即以总股本

52,160万股为基数,每10股送1股并转增2股,实施后公司总股本增至67,808万股,股本结构如下:

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件流通股	114,017,961	16.81
其中:		
国有法人持股	0	0
境内法人持有股份	114,017,961	16.81
二、无限售条件流通股	564,062,039	83.19
合计	678,080,000	100.00

截至2011年12月31日,公司总股本为678,080,000股,股本结构如下表所示:

股份性质	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0
二、无限售条件流通股	678,080,000	100.00
1.人民币普通股	678,080,000	100.00
2.境外上市的外资股	0	0
3.境外上市的外资股	0	0
4.其他	0	0
三、股份回购	678,080,000	100.00

截至2011年12月31日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
上海鹏盛科技实业有限公司	172,493,513	25.44	0
吉林中小企业信用担保有限公司	17,940,000	2.63	0
吉林省交通厅-东风汽车股份有限公司	3,400,000	0.50	0
国信证券	2,293,050	0.34	0
方正证券股份有限公司客户信用交易担保基金	1,942,468	0.29	0
中国工商银行股份有限公司-富安达阿尔法策略股票证券投资基金	1,838,171	0.27	0
晋西	1,815,840	0.27	0
王曼云	1,700,000	0.25	0
福海花	1,697,890	0.25	0
范洪明	1,635,928	0.24	0

截至2011年3月31日,上海鹏盛科技实业有限公司所持有的157,710,732股处于质押状态。
四、发行人的主要风险
(一)财务风险
1.资产与负债结构不匹配导致的风险
报告期内,发行人资产与负债的匹配情况(合并报表口径)如下表所示:

	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
流动资产占资产总额的比例(%)	48.27	49.17	45.65
流动负债占负债总额的比例(%)	96.40	87.02	94.88
流动资产与流动负债的比例(%)	103.19	114.38	107.67
非流动资产占非流动负债的比例(%)	2,960.67	792.62	2,375.64

报告期内,公司流动资产占总资产的比例平均为47.70%,流动负债占总负债的比例平均为92.77%,流动性资产与流动负债的比例平均为108.41%,非流动资产与非流动负债的比例平均为2,042.98%,显示出公司资产与负债在期限结构上存在一定的不匹配风险。尽管发行人货币资金比较充裕,资产质量相对较高,盈利能力较强,经营活动产生的现金流量充沛,具有较好的短期偿债能力,但随着公司业务不断拓展,特别是进行项目投资需要匹配相应的铺底流动资金和营运流动资金,维持合理的流动性资产以充分满足运营的资金需求,可能会给发行人带来一定的短期资金周转压力,从而对发行人的偿债能力造成一定的负面影响。
二、汇率波动风险
报告期内,公司进出口业务收入及占主营业务收入比例情况(合并报表口径)如下:

发起人(外币)	2011年度	2010年度	2009年度
主营业务收入(外币)	29,711,000	21,669,511	12,519,500
主营业务收入(人民币)	108,664,390	113,577,022	104,954,311
占主营业务收入比例(%)	27.34	19.08	11.93

随着公司海外市场的不断拓展,出口收入占主营业务收入的比例在逐步上升,出口收入目前全部以外币结算(其中相当部分为美元)。2005年9月21日国家启动人民币汇率形成机制改革以来,人民币升值趋势明显,包括美元在内的外币对人民币的不确定性在一定程度上的波动,给公司的进出口业务带来一定的汇率波动风险,从而对公司经营产生一定的负面影响。
三、市场竞争风险
公司是目前国内最大的功率晶体管提供者和分立器件前道制造企业,在中国半导体行业协会公布的2005年中国十大集成电路与分立器件制造企业“名牌产品”名列前十,是其中唯一的半导体分立器件制造企业。行业地位突出。2009-2011年,公司营业收入分别为108,046.64万元、114,796.30万元和109,811.56万元,增幅依次提升。尤其是近年来公司致力于中高端产品的开拓,VDMOS、IGBT及快恢复二极管等新型功率器件的推出提升了公司整体附加值水平和市场竞争力,但近年来越来越越多的国内生产厂家开始进入功率半导体行业,本公司部分产品面临一定的国内同业竞争的冲击。同时,随着我国对外开放的程度不断加深,境外知名公司的功率半导体产品加速向中国转移,并在产品技术和质量上优势明显,公司将进一步面临国外公司及国内合作伙伴的竞争,从而可能对公司市场销售带来一定的冲击。在面临国内、国际两个市场同业竞争的挤压之下,公司部分成熟产品的销售价格可能出现一定程度的下降,导致毛利率水平存在下行的风险。
四、行业周期性波动风险
公司所在的功率半导体行业受国内外宏观经济波动的影响较大。2002-2007年随着经济的快速平稳发展,我国功率半导体行业保持快速增长,但自2008年二季度以来,由于受全球金融危机迅速波及实体经济的影响,国内市场对功率半导体产品的需求大幅度萎缩,我国功率半导体行业的增速回落。2010年以来,由于国内宏观经济回暖,以及一系列促消费保增长的政策效应的显现,国内消费电子、计算机等产品的市场需求回升,功率半导体市场呈现良好的上升态势,由于受经济周期波动的影响,功率半导体行业呈现一定的周期性波动特点,对本公司盈利状况影响较大。2009-2011年,公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,603.70万元、8,249.09万元和10,174.25万元。虽然我国宏观经济发展的基本面和长期向好趋势不会发生较大改变,总体呈现高速增长的趋势,但当前国内外经济形势极为复杂,欧洲债务危机尚未得到有效解决,国内经济也存在发展不平衡等问题,不排除在未来出现周期性波动的可能性。尽管公司在行业半导体的领域具有一定的规模优势并具有较强的盈利能力,但受宏观经济周期波动的影响,行业呈现一定的周期性,本公司经营业绩和盈利能力也存在一定程度的波动风险。
五、原材料价格波动风险
目前公司产品的主要原材料是单晶硅片、铜引线框架、塑封料、化学药、均属于资源类、能源类产品,原材料成本占公司营业成本的50%以上,其价格受市场供求状况的影响较大。公司主要原材料采购成本受多晶硅及铜的市场供求状况及价格走势的影响存在较大的波动。虽然公司一直通过材料集中采购、招标采购等方式降低采购成本,但是如果原材料价格发生剧烈波动,将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平,从而使公司盈利能力存在波动的风险。

(二)管理风险
1.公司研发分散的管理风险
功率半导体器件的制造涉及微电子学、固体物理学、光学、材料学等十余个学科的交叉综合应用,同时生产精细和精度要求高,对产品的生产管理和质量管理提出了较高要求。近年来,行业技术不断更新,市场需求不断变化,对公司的研发能力、产品设计和生产管理能力提出了更高的要求,增加了管理的难度和风险。另外,公司业务分散分布在在全国多个省市和国外多个国家地区,业务辐射面广,管理跨度大,环节多,对管理制度的适应性提出了更高的要求,同时跨区域制度执行难度加大,增加了潜在的管理风险。
2.专业技术人员流失的风险
功率半导体行业对专业技术人员的需求比较突出,同时保持领先的技术研发优势是公司核心竞争力的重要组成部分,因此人才的储备对公司发展意义重大。目前公司已培养并造就了一批专业水平与忠诚度较高的业务骨干核心人才,并加大了对高端人才的引进力度,但随着公司新产品不断的开发和应用,如果公司未来未能有效引进和留住人才,导致导致核心技术的研究、技术人员流失,不仅将削弱公司的研发能力,还可能给公司的核心技术泄漏,对公司产生不利影响。
(三)政策风险
1.行政政策变动的风险
本公司及下属子公司均根据国家有关法律、法规的规范履行税收政策,国家相关税收政策的变化可能会对公司经营业绩产生一定的影响。
2.税收优惠政策变化的风险
发行人及下属子公司均根据国家有关法律、法规的规范履行税收政策,国家相关税收政策的变化可能会对公司经营业绩产生一定的影响。
3.环保政策变化的风险
发行人及吉林麦吉柯半导体有限公司(以下简称“吉林麦吉柯”)于2008年11月被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合认定为高新技术企业,根据2011年12月27日吉林省科学技术厅《关于公布2011年全国高新技术企业复审合格名单的通知》(吉科发[2011]66号),发行人及吉林麦吉柯已通过高新技术企业复审,并作为高新技术企业予以备案,获得高新技术企业证书(证书文号:GF201122000008,吉林麦吉柯证书编号:GF201122000034,发证日期均为2011年10月13日,证书有效期均为三年),发行人及吉林麦吉柯2011年-2013年将享受高新技术企业税收优惠政策优惠。
如果国家税收政策未来发生变化,将可能对公司及下属子公司已享受的税收优惠政策产生影响,进而对公司的经营业绩产生影响。

第三节 债券发行概况

一、债券名称
吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券(简称“11华微债”)。
二、债券发行批准机关及文号
本期债券已经中国证监会证监许可[2012]310号文核准发行。
三、债券发行规模
本期债券发行总额为3.2亿元人民币。
四、债券的发行方式
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购采取“时间优先”的原则成交,网下申购由发行人与主承销商根据网下申购情况进行协商。网下发行对象为:在登记公司开立合格投资者账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
五、债券发行的承销机构和承销团成员
本期债券由主承销商华融证券股份有限公司负责承销组织,以余额包销的方式承销。
本期债券的主承销商为华融证券股份有限公司,分销商为中国建信证券股份有限公司。
六、债券期限
本期债券期限为100天,按面值平价发行。
七、债券存续期间
本期债券存续期间为第5年末及未发行人在票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券票面利率、计息方式和还本付息方式
本期债券票面利率为8%,在债券存续期的前5年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分在存续期后2年票面利率为债券存续期限前5年票面利率上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。
本期债券采用单利按年计息,不计复利。
本期债券按年付息,到期一次还本,利息与本金一起支付,最后一期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日至前次付息日,本金自本金兑付日起不计利息。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
九、发行首日和起息日
本期债券的发行首日和起息日为2012年4月10日。
十、付息日
本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月10日(法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的4月10日(法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息)。
十一、兑付日
本期债券的兑付日为2019年4月10日(法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年4月10日(法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息)。
十二、本息支付方式
本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体

安排按照债券登记机构的相关规定办理。
14.担保安排
本期债券以本公司合法拥有的分别位于吉林市高新区深圳街99号、吉林市高新区长江街100号以及吉林省昌图县桂林大街江城化工总厂的部分土地及其他地上房屋建筑物按法定设定抵押,以保证本期债券本息按期足额如期兑付。
15.债券评级机构和债券信用等级
鹏元资信评估有限公司综合评定,发行主体长期信用等级为AA-,本期公司债券信用等级为AA-。
16.募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,用于补充公司流动资金。
17.本期债券受托管理人
华融证券股份有限公司。
18.募集资金的验资确认
本期债券募集资金支付人民币3.2亿元,其中网上公开发行0.5亿元,网下发行2.7亿元。扣除发行费用之后的募集资金净额已于2012年4月13日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的上海众华会计师事务所对本期债券募集资金到位情况进行了编号为沪众会验字[2012]第06675号的验资报告。

19.回购安排及安排
二、本期公司债券上市与托管基本情况
一、本期公司债券上市基本情况
经上海证券交易所同意,本期债券将于2012年2月27日起在上海证券交易所挂牌交易,本期债券简称为“11华微债”,证券代码为“122134”。
二、本期公司债券托管基本情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

三、最近三年的母公司财务报表
1.母公司资产负债表

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
流动资产	669,464,397.49	641,538,983.25	406,961,838.18
非流动资产	170,183,617.69	133,429,462.31	44,400,678.24
应收款项	164,870,722.87	183,104,464.97	219,639,880.24
预付账款	36,954,371.00	79,996,405.00	65,308,299.52
其他应收款	19,042,535.66	31,598,063.01	102,327,417.99
存货	183,314,313.34	192,796,483.33	213,378,569.81
流动资产合计	1,344,479,956.05	1,362,463,846.87	1,046,195,175.07
非流动资产合计	157,350,207.50	188,360,018.01	216,309,106.38
长期股权投资	93,172,723.94	94,672,676.97	96,740,947.97
固定资产	962,737,958.11	967,689,791.98	656,554,086.79
在建工程	84,613,341.07	1,305,564,928.35	275,275,975.17
无形资产	190,679,240.76	142,124,738.64	142,323,243.92
长期待摊费用	8,912,470.33	12,861,744.60	11,644,070.23
递延所得税资产	8,088,988.85	7,490,941.93	5,347,442.44
流动资产合计	1,305,564,928.35	1,435,773,787.64	1,404,775,574.88
资产总计	2,850,044,884.40	2,798,237,634.51	2,450,970,749.95

一、最近三年财务报告审计情况
公司报告期内财务报告按照